

研究成果報告書 (掲載期間 2017.11-2018.10)

電気電子工学科 山田靖

審査学術論文

- (1) 山田靖: パワー半導体実装用接合材料の特性評価法, エレクトロニクス実装学会誌, 21 巻, 2018, 6 号, pp.579-585.

学会発表

- (1) 山田靖: 超高熱伝導グラファイトのパワーデバイス実装への応用, エレクトロニクス実装学会, 2018 ワークショップ, 2018 年 10 月, 修善寺.
- (2) 長谷川和基, 池田裕亮, 笠木靖文, 片桐克弥, 加藤裕和, 渡邊裕樹, 竹中彰宏, 山田靖, 佐野義之, 長田裕仁, 関根信博: 無加圧窒素雰囲気による銅ナノ粒子接合の信頼性, エレクトロニクス実装学会, 第 28 回マイクロエレクトロニクスシンポジウム(MES2018), 2018 年 9 月, 大阪.

その他

- (1) T.Ishizaki, D.Miura, A.Kuno, K.Hasegawa, M.Usui, Y.Yamada : Young's modulus of a sintered Cu joint and its influence on thermal stress, KAMOME 成果報告会, 2017 年 11 月, 横浜.
- (2) 長谷川和基, 粕谷雅人, 金子俊輔, 梶村優太, 山田靖, 長田裕仁, 佐野義之: 無加圧窒素雰囲気における銅ナノ粒子接合の特性評価, KAMOME 成果報告会, 2017 年 11 月, 横浜.
- (3) 山田靖: 接合材料 WG, KAMOME 成果報告会, 2017 年 11 月, 横浜.